

# FIB低加速加工

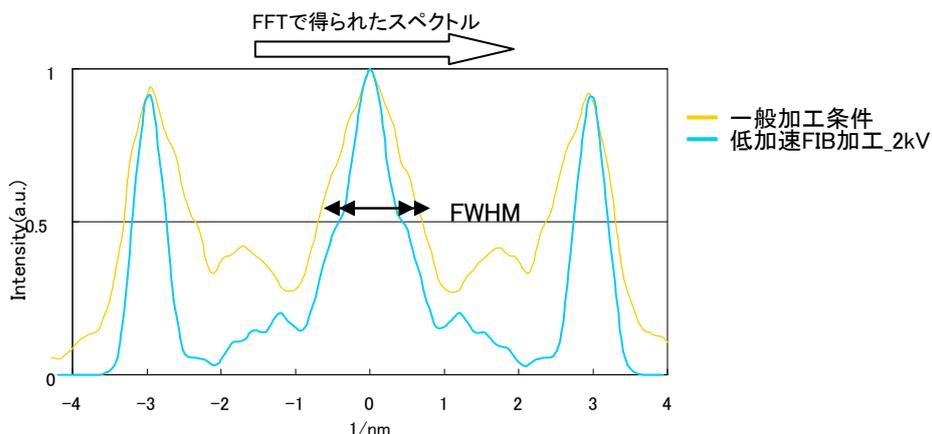
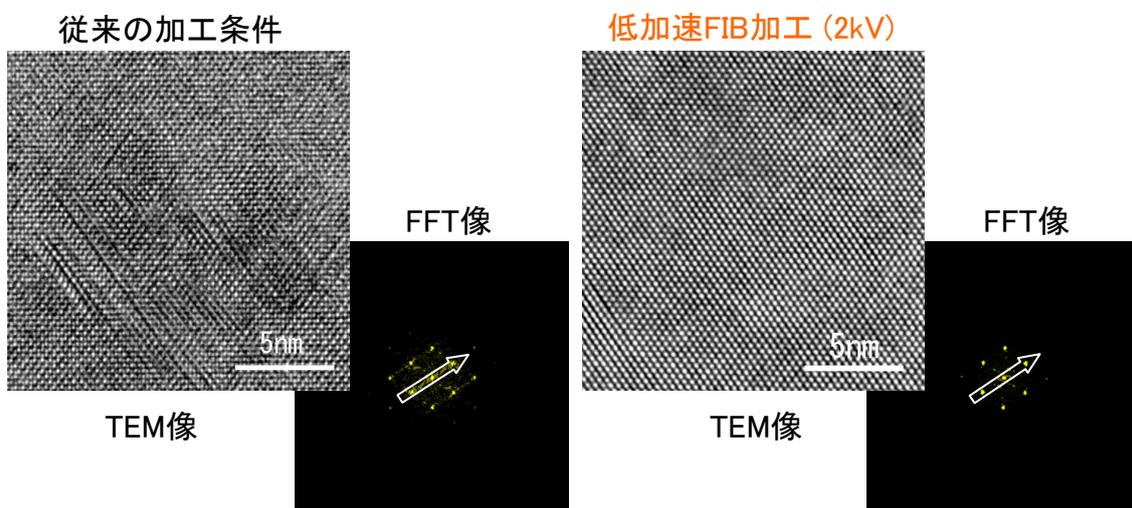
## FIB：集束イオンビーム加工

### 概要

FIBを用いたTEM観察用薄膜試料作製法では、高エネルギーのGaイオン(加速電圧30kV)を用いており、加工面にダメージ層が生じ、TEMの像質低下の原因となっています。そこで従来より低加速(2kV)の加工を行うことでダメージ層が低減でき、像質が改善されました。  
FIB低加速加工によりFIB加工面のダメージを低減することで、TEM像観察、EELS測定において高品質で信頼性の高いデータが得られます。

### データ例

■従来の条件と低加速条件の比較：InP基板



	従来の加工条件	低加速FIB加工
Center spotのFWHM(1/nm)	約1.4	約0.8

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人  
**MST** 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp  
URL : http://www.mst.or.jp/